

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-030

深南电路股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年5月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕4151号）核准，公司2021年度非公开发行人民币普通股23,694,480股，共计募集资金总额2,549,999,937.60元，扣除与发行有关的费用人民币20,335,154.66元，实际募集资金净额为人民币2,529,664,782.94元。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第Z110015号）。

（二）前次募集资金存放情况

截至2026年5月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2023 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南电路有限公司变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公司。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况详见本报告附件 1。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、本公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目无对外转让的情况。

2、2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10019 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。公司于 2022 年 2 月完成了募集资金置换。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用期限

自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

2022年12月28日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

2024年12月27日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5.60亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。

截至2026年5月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，且都已到期，到期赎回的本金和收益已归还至募集资金专户，不存在尚未到期的理财产品。

（六）未使用完毕募集资金的情况

截至2026年5月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，不直接产生经济效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2026 年 6 月 12 日批准报出。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 5 月 31 日

编制单位: 深南电路股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:		252,966.48	已累计使用募集资金情况							
报告期内变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额		259,274.44					
累计变更用途的募集资金总额		-	2022 年度:		160,421.66					
累计变更用途的募集资金总额比例:		-	2023 年度:		32,557.91					
			2024 年度:		10,645.46					
			2025 年度:		55,649.40					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	
1	高阶倒装芯片用 IC 载板产 品制造项目	高阶倒装芯片用 IC 载板产 品制造项目	180,000.00	180,000.00	131,312.76	180,000.00	180,000.00	131,312.76	48,687.24	2022 年 9 月 30 日
2	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	72,966.48	73,196.88	75,000.00	72,966.48	73,196.88	-230.40	不适用
3	——	永久补流	——	——	54,764.80	——	——	54,764.80	-54,764.80	不适用

合计	255,000.00	252,966.48	259,274.44	255,000.00	252,966.48	259,274.44	-6,307.96	——
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	----

注：1、“达到预定可使用状态”系指项目连线试生产后，即已能够正常生产出合格产品时。

2、补充流动资金的募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差异系支付相关发行费用，补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-230.40万元，系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。

3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-6,307.96万元，差异原因系公司闲置募集资金现金管理收益和专户存款利息扣除银行手续费后的净额用于该项目的支出。

4、2025年3月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。报告期内，公司使用“高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目”节余募集资金54,764.80万元（包括累计收到的投资收益和银行存款利息并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。该项目出现募集资金结余并用于永久补流的原因具体为：

①2023年公司根据业务发展需要，将无锡深南持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至无锡广芯，划转的封装基板业务包括高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目，厂房不在划转范围内，建设厂房部分款项使用自有资金支付；此外，在项目推进过程中，公司结合实际资金需求和规划，统筹安排资金来源，对部分阶段性资金需求先行使用自有资金支付；

②募投项目部分合同余款支付时间周期较长，部分尾款尚未支付，公司将按约定继续支付；

③在不影响募投项目实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理及活期存款产生了一定的收益；

④在项目实施过程中，公司结合下游市场和项目实际情况，在满足现阶段的实际需求前提下，按需增设设备资源，在募集资金计划投入范围内缩减了一定投入金额，该部分金额较小。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 5 月 31 日

编制单位: 深南电路股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目	不适用	达产年均净利润为 21,516 万元	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用	不适用 ²
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ³
3	永久补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ³

注: 1、高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目在 2023 年至 2025 年内处于爬坡阶段, 尚未进入完整达产年度, 产能与效益尚未完全释放;

2、高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目按项目达产年年度口径承诺效益, 2026 年 1-5 月非完整会计年度, 故实际效益情况为不适用; 本项目达产后正常经营年份年均净利润为 21,516 万元, 2026 年 1-5 月项目净利润为 16,769 万元, 已实现达产年完整年度承诺净利润的 78%;

3、补充流动资金与永久补流项目为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障, 不直接产生经济效益。